

证券代码：301251

证券简称：威尔高

江西威尔高电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026 -002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年04月30日 16:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 邓艳群 董事会秘书 贾晓燕 投关经理 余洁 业务副总经理 谢清泉 保荐代表人 曾文强 保荐代表人 帖晓东 独立董事 刘木勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问领导，根据当前的市场环境和公司的战略规划，公司对未来几年的业绩展望是怎样的</p> <p>答：尊敬的投资者您好，面对 AI 算力爆发与数据中心供电架构快速升级的产业机遇，公司将以 DC/DC 为代表的高端电源 PCB 作为战略性倾斜与近年优先发展的核心方向。未来三年，公司将进入高质量发展的关键时期，重点把握 AI 电源需求的重要机遇，将战略规划落至实处，以业务国际化与产品高端化为两大核心发力方向。业务方面，公司积极推进海外布局，以泰国事业部作为</p>

海外桥头堡，致力于为更多海外头部客户提供最前沿一体化的高端产能，协同国内生产基地，构建起国内国际双循环的良好市场布局。产品方面，公司通过强研发、深拓展的具体实践行动，实现现有产品快速、稳定、高良率极致交付，增强在高多层、高频高速、HDI 等高端产品的量产能力。未来随着AI电源产品占比进一步提升，公司盈利能力有望得到显著增强。感谢您对公司的关注。

2. 董秘您好，请问公司现有产能情况如何？是否考虑自建或并购的形式增加产能？谢谢

答:尊敬的投资者您好,公司目前国内外生产基地产能利用率均保持在90%以上(包括惠州、江西基地及泰国威尔高工厂),且新产能正在积极释放中。2025年总产能312万平米/年,2026年上半年444万平米/年,2026年下半年516万平米/年。后期土地储备充足,现阶段更专注于通过自建方式扩大产能(如江西工厂二期建设、泰国二期建设),以应对AI等行业快速增长的需求。未来若有战略调整,公司将依法及时披露。感谢您对公司的关注。

3. 董秘您好，请问公司首发募投项目的最新进展如何？

答:尊敬的投资者您好,公司首发募投项目“年产300万m²高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目一年产120万平方米印制电路板项目”的最新进展如下: 1. 该项目于2025年4月正式开工建设,2026年1月进入设备安装调试、工序试产,预计2026年6月初全面投产。感谢您对公司的关注。

4. 在行业竞争加剧的背景下，威尔高的差异化竞争优势是什么？如何持续强化这一优势？

答:面对全球的竞争与同行竞争,威尔高正在进行高质量的转型升级,从竞争力的角度来看,是从质量的竞争、研发的竞争、产品的竞争做全面升级。威尔高从创业初始就选择了电源和厚铜细分赛道,以大客户品牌战略+技术研发+产品质量+快速服务一体化的极致交付为核心竞争优势,深耕电源、工控、厚铜板领域,在该领域客户中有较高的市场份额和影响力。未来,公司将继续落实强研发、深拓展行动,进一步深入对多高层板、高频高速板、HDI特殊工艺板的研发。AI电源高端产品方面,DC/DC电源模块作为AI供电的关键环节,正成为最具备增长潜力的细分领域之一。

公司将针对性开发DC/DC高端电源应用所需的超厚铜、嵌埋式等高端PCB工艺，围绕行业发展趋势，重点发展产品利润空间大的新兴产品，进一步增强技术领先优势，从而不断迭代公司的收入与利润增长点。感谢您的关注！

5. 公司是否有计划通过并购或战略合作拓展新业务领域？

答:尊敬的投资者您好，公司目前暂无并购重组计划。未来如有相关战略调整，公司将严格按照法律法规履行信息披露义务。公司目前更专注于现有业务的优化和市场拓展，致力于提升核心竞争力和盈利能力。当前重点把握AI电源需求的重要机遇，以业务国际化与产品高端化为两大核心方向，通过泰国生产基地的顺利投产和江西工厂二期建设扩大产能，深化国内外市场布局。感谢您对公司的关注！

6. 请问公司研发投入占比是否会持续增加？如何评估研发成果对收入的转化效率？

答:尊敬的投资者您好，公司根据行业发展及客户需求，始终坚持就高多层、HDI高阶、高频高速等核心关键技术方向进行稳定的研发投入，在AI服务器电源DC/DC、通讯设备、汽车电子等前沿领域形成研发成果的转换，为公司高质量发展提供坚实支撑。具体研发数据请您关注公司披露公告，谢谢！

7. 原材料成本占比较高，公司未来如何通过供应链优化或技术替代降低价格波动风险？

答:尊敬的投资者您好，原材料涨价对公司业绩的影响主要体现在成本端，公司已采取以下策略： 1. 海外产能布局：通过泰国工厂承接中高端订单(如AI电源产品)，有效对冲贸易风险并提升经营韧性，2025年泰国工厂良率改善带动利润由亏转正。 2. 技术升级：研发DC-DC(如30层AI高厚铜电源板)，优化产品结构以提升附加值，相关技术已进入小批量供货阶段。 3. 成本管控：通过镍钯金工艺、薄板树脂塞孔等技术研发降低生产损耗(如电镀铜锡用量减少30%)，同时优化供应链管理。 4. 客户端价格调整：通过积极沟通，将材料涨价影响合理向下传导，陆续得到客户的不同幅度的调价，以增加收入和毛利率。 未来公司将持续关注原材料价格波动，通过技术迭代和产能效率优化平衡成本压力。

	<p>感谢您对公司的关注。</p> <p>8. 产能利用率目前处于什么水平？未来扩产计划是否与市场 需求匹配？</p> <p>答:尊敬的投资者您好，目前国内外产能利用率均保持在90%以上（含惠州、江西及泰国基地），且新产能正在积极释放中。关于扩产计划，公司2025年已开展产能扩张，主动应对AI行业快速发展需求，泰国基地项目于2024年6月投产后产能爬坡顺利，2025年半年度已实现盈利。2025年年度报告显示，公司印制电路板销售量同比增长47.91%，生产量增长55.07%，均与产能扩张形成同向变动。未来公司将根据市场动态调整扩产节奏，确保与市场需求相匹配。感谢您对公司的关注。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年04月30日